

简介:采用表面覆盖SiO<sub>2</sub>的TC-SAW谐振器的温补 效果和Q值是其研究设计的重点,本文基于 COMSOL压电耦合多物理场对TC-SAW谐振器进 行结构上的优化设计,可有效提高SAW谐振器的 Q值和温补能力。

结果: SiO<sub>2</sub>的厚度除了会影响谐振器工作频率, 还会影 响主振模态谐振峰Q值(图3); piston mode的结构有 助于减少横向模态引入的杂波, 增大了谐振峰处的Q值 (图4); 由于模型材料参数包含了温度系数, 可同时 仿真SiO<sub>2</sub>的温补效果(图5)。



![](_page_0_Picture_5.jpeg)

![](_page_0_Figure_6.jpeg)

$$0 = \nabla \cdot S + Fv$$
$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho v$$